



## **SOITEC ANNONCE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUBSTRATS AVANCÉS**

**Une nouvelle gamme qui couvre l'ensemble des applications  
et des structures de transistors au-delà de 45nm**

**BERNIN, France — 15 juillet 2008** — Soitec (Euronext Paris), le premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI) et autres substrats innovants utilisés en micro-électronique lance une nouvelle génération de substrats avancés dédiée aux applications et architectures de transistors que développe l'industrie pour les nœuds technologiques au-delà du 45 nm.

Cette nouvelle gamme avec des couches supérieures et d'isolant ultra minces offre aux concepteurs d'architecture de transistors une totale flexibilité dans leurs choix d'un substrat «Partially Depleted (PD)» ou «Fully Depleted (FD)» y compris pour les structures multi grilles les plus avancées (FinFET ou Trigate).

Cette nouvelle génération de substrats s'appuie sur le succès de la gamme de plaques Unibond™ XUT+ de taille 300 mm qui sont actuellement livrées aux clients des marchés de la haute performance en 45nm (PD) mais qui sont également en phase de qualification chez d'autres clients pour des applications plus variées.

Paul Boudre, Directeur Général Délégué de Soitec a précisé : « Les clients de Soitec disposent désormais d'une gamme élargie de matériaux pour les aider dans leurs choix stratégiques pour les technologies mises en œuvre en 32nm et au-delà. Les concepteurs de circuits peuvent notamment bénéficier d'une ingénierie en matériaux dans leur démarche de miniaturisation et de réduction de la consommation énergétique en réduisant fortement les variations de tension, garantissant ainsi une meilleure stabilité de leurs structures. Les avantages qu'offre l'ingénierie des matériaux sont désormais déterminants dans la conception des circuits. En complément de ceux-ci, les simplifications usuelles dans les procédés CMOS, et les solutions les plus avancées de mémoire sur SOI (1T1C ou ZRAM) conduisent à une réduction notable du coût d'utilisation du SOI. »

Cette nouvelle génération des substrats, utilise la technologie brevetée Smart Cut™. Elle est conçue pour répondre aux exigences les plus avancées en termes de fiabilité, de qualité de surface et de contrôle de l'épaisseur de l'isolant avec une précision de  $\pm 10$  angströms (Å). La couche supérieure de silicium de ces plaques est disponible en différentes épaisseurs, de 20 nm à 110 nm, tandis que la couche de l'isolant (oxyde enterré ultra mince) peut être limitée à 10 nm. Les options de substrats à haute résistivité ou contraints sont également disponibles.

### **À propos du Groupe Soitec :**

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les

plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet [www.soitec.fr](http://www.soitec.fr)

*Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.*

***Pour toute information, merci de contacter:***

**Relations Presse – H & B Communication**

Mathieu Ferrié – Nadège Chapelin – Tel. 33 (0)1

58 18 32 49 - 45

Email : [m.ferrie@hbcommunication.fr](mailto:m.ferrie@hbcommunication.fr)